

超颖电子电路股份有限公司

关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金 投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段
- 募投项目结项后节余募集资金及超募资金安排：公司拟将节余募集资金 6,245.42 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金 14,316.22 万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第三阶段”
- 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》，确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”（以下简称“募投项目”）结项，同意将节余募集资金6,245.42万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金14,316.22万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第三阶段”（以下简称“新项目”）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项尚

需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市。本次发行的发行价格为17.08元/股，募集资金总额为人民币896,700,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币93,537,811.80元后，募集资金净额为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月21日出具的《验资报告》（华兴验字[2025]23008410841号）审验。

公司已按照相关法律法规的规定与保荐机构（主承销商）及存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金及超募资金使用情况

截至2026年2月28日，本次发行的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	累计使用募集资金投入金额	投资进度
1	超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段	40,000.00	33,436.15	83.59%
2	超颖电子电路股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	26,000.00	26,000.00	100.00%
合计		66,000.00	59,436.15	-

本次发行的超募资金共计14,316.22万元；截至2026年2月28日，前述超募资金均尚未使用。

三、本次募投项目结项及募集资金预计结余情况

（一）本次募投项目结项情况

本次拟结项的募投项目为“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”。该项目目前已全部建设完毕，生产线能够稳定生产，达到预定可使用状态。

鉴于上述募投项目已初步达到预期目标，同时考虑到公司新项目建设对资金的需求，为更好使用募集资金，公司拟对上述募投项目进行结项并将节余募集资金和超募资金投资新项目。

（二）拟结项的募投项目资金使用及预计节余情况

截至 2026 年 2 月 28 日，“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段”的资金使用及预计节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	待支付的款项	利息及理财收益扣除手续费后净额	节余募集资金金额
超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段	40,000.00	33,436.15	339.33	20.90	6,245.42

注：节余募集资金金额为截至 2026 年 2 月 28 日募集资金账户余额扣除待支付款项后预计结余金额，实际结余金额以未来资金转出当日募集资金专户余额扣除待支付款项之后的金额为准。

（三）本次拟结项的募投项目募集资金节余的原因

在募投项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段”建设前期，公司已使用自有资金投入部分相关建设，且后续未使用募集资金对该部分投入进行置换，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。

四、节余募集资金及超募资金的使用计划

为进一步提升公司资金的使用效率，公司拟将上述预计节余募集资金 6,245.42 万元（以资金转出当日上述项目对应的专户余额扣除待支付款项之后的金额为准）以及超募资金 14,316.22 万元用于建设“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第三阶段”，新项目具体情况如下：

（一）新项目基本情况和投资计划

- 1、项目实施主体：超颖电子电路股份有限公司
- 2、项目名称：超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第三阶段
- 3、项目建设地点：黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特 88 号
- 4、项目建设内容：通过引进高精度、高自动化生产设备，聚焦 HDI 板、高多层板等高端产品布局，突破公司产能瓶颈，提高客户订单交付能力，从而满足

网络通讯及服务器、汽车电子等高速增长的下游市场对高端 PCB 产品的需求。通过优化产品结构与产能布局，巩固并加强公司在印制电路板行业的综合竞争力，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。新项目达产年将形成年产 12.76 万平方米印制电路板的生产能力，用于网络通讯及服务器、汽车电子等领域。

5、项目投资规模及资金来源：新项目总投资约人民币 42,119.23 万元（最终以实际投资金额为准），资金来源为公司本次拟结项募投项目预计节余募集资金 6,245.42 万元、超募资金 14,316.22 万元以及公司自有或自筹资金。前述资金全部用于项目建设，具体投资明细如下：

序号	费用名称	金额（万元）	占比
1	场地投入	3,314.10	7.87%
2	设备投入	34,846.73	82.73%
3	基本预备费	1,908.04	4.53%
4	铺底流动资金	2,050.36	4.87%
合计		42,119.23	100.00%

6、项目建设期限：24 个月

7、项目备案及审批情况：目前该项目尚未完成投资项目备案等程序，相关手续正在办理过程中。

新增的募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）新项目必要性分析

1、突破现有产能瓶颈，提高客户订单交付能力

近年来，受益于新能源汽车渗透率提升、AI 技术商业化落地及存储芯片国产化推进，高端 PCB 应用领域需求爆发式增长。公司精准把握机遇，成功切入多家头部企业供应链，高多层及 HDI 板订单量激增，产能瓶颈已成为制约公司承接大额订单、营收稳步增长的核心瓶颈。新项目的实施将使公司突破产能瓶颈，提高客户订单交付能力，满足持续增长的市场需求。

2、巩固技术领先优势，适配高端产品工艺迭代需求

当前，全球印制电路板行业正迎来以新能源汽车、人工智能、大数据中心、

5G 通信为核心的新兴需求驱动发展周期，行业整体结构持续向高端化、精细化、高附加值方向迭代升级。新项目拟通过购置高精度、高自动化生产设备，满足产品在微细线宽线距、微小孔径、高层压数等方面的高精密度加工需求，进而有效提升高多层板及 HDI 板的生产效率、核心工艺精度与产品品质，稳步保障高端产品的成品率与全生命周期性能稳定性，持续强化公司在高端 PCB 产品领域的核心供应能力与市场竞争优势。

3、把握行业发展机遇，增强公司核心竞争力与市场地位

新项目实施将依托公司现有客户资源、技术积累与管理优势，进一步拓展高端应用领域市场份额，优化产品结构与产能布局，全面提升公司核心竞争力、行业影响力与可持续发展能力，巩固公司在高端 PCB 领域的竞争优势，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

（三）新项目的可行性分析

1、在国家产业政策引导与下游应用领域持续升级的双重驱动下，公司精准把握行业发展机遇，积极响应政策导向，将新项目的规划与实施深度契合产业发展趋势。新项目符合国家当前及未来对高端印制电路板产业的扶持方向，具备充分且可持续的政策环境可行性。

2、公司深耕 PCB 制造领域多年，凭借优秀的核心技术研发团队、深厚的专利储备与核心技术积累，以及完善的技术支撑体系，为新投资项目的顺利推进、高效实施及落地交付提供了坚实的保障。

3、公司优质稳定的客户资源，叠加行业固有的高合作黏性与长期稳定的合作基础，为新项目的投产及消化奠定了良好的市场基础与可持续的业务保障。

（四）新项目可能存在的风险及应对措施

1、新增产能消化不及预期风险

若项目投产后出现下游市场增速放缓、行业竞争加剧等情形，新项目存在新增产能消化风险。对此，公司将重点围绕高端 PCB 需求旺盛领域，积极开发行业内头部及优质潜力客户，突破现有客户结构限制，拓宽高端产品销售渠道，提升新增产能的市场承接能力。同时，公司也将结合高端产品订单获取、客户验证进度及市场需求变化，灵活、有序、分阶段释放新增产能，避免产能集中投放带来的消化压力，确保产能利用率维持在合理水平。

2、项目实施效益不及预期风险

若项目实施及投产后出现宏观经济下行、市场需求下滑等情形，将可能导致新项目实际效益不及预期。对此，公司将紧密跟踪宏观经济、产业政策及下游市场需求变化，提前开展客户认证与订单储备；持续加大研发投入，优化产品结构与工艺水平，紧跟行业技术发展趋势；建立稳定多元的供应链体系，强化集中采购与成本管控，平抑原材料价格波动；根据市场环境及订单获取情况，合理把控项目建设进度与产能释放节奏；同时不断完善市场开拓机制，深化与核心客户合作，积极拓展优质客户资源，多措并举保障新项目顺利实施并实现预期效益。

3、全球宏观环境不确定性风险

若未来全球经济增速放缓甚至迟滞，印制电路板行业发展速度将放缓或陷入下滑，对公司的业务发展及营业收入增长产生负面影响。但是，公司在 PCB 行业深耕多年，凭借优良的产品品质和优质的技术服务，公司在行业中塑造了较好的品牌形象，并赢得较好的市场口碑。公司建设新项目，旨在增强公司的 HDI 和 HLC 产能，丰富公司产品类型，优化产品结构，以应对市场的不确定性。此外，公司多年来积累的优质、稳定的客户资源，能够有效降低因宏观环境变化而造成的市场风险。

4、原材料价格波动风险

公司原材料占主营业务成本的比例较高。未来若原材料价格出现大幅波动，公司的经营业绩将受到不利影响。对此，公司将采取措施加强对供应链的管理能力，增强公司抵御风险的能力。同时，公司还将继续完善采购、库存等方面的管理制度，并加强经验丰富的采购管理人员的任用，加强对原材料市场变化趋势的预判，进一步降低原材料价格波动带来的风险。

5、市场竞争加剧风险

全球印制线路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分，且近年来竞争逐渐加剧。对此，在项目建设过程中，公司加强对新产品的研发以及对现有产品的技术改造和升级，提高产品的市场竞争力。公司也将加大生产工艺的研发投入力度，对生产工艺进行优化和改良。此外，通过新项目的建设，公司的产能得到了极大的提升，使公司能够实现更大批量的规模化生产，进一步降低生产成本，提高公司盈利能力和市场竞争力，从而在激烈的市场竞争中获得产品价格优势。

五、本次募投项目结项及使用节余募集资金和超募资金投资建设新项目对公司的影响

本次募投项目结项并使用节余募集资金和超募资金投资建设新项目，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和经营能力，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》，确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”结项，同意将节余募集资金6,245.42万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金14,316.22万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第三阶段”；同时，同意公司依据募集资金管理的要求为新项目开立募集资金存放专项账户（如需），并授权公司董事长或其进一步授权人全权处理与前述募集资金存放专项账户开立相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金存放专用账户、与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议等。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

（二）保荐机构意见

超颖电子电路股份有限公司募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。根据公司的投资与建设规划，该事项有利于提高募集资金的使用效率，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的安排，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年3月12日